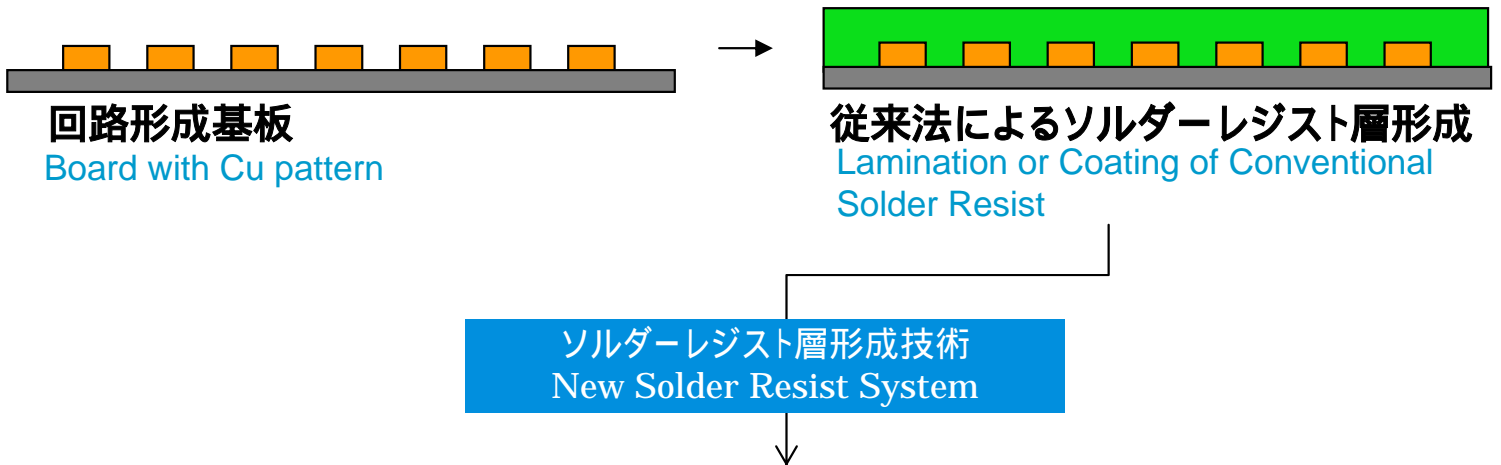


ソルダーレジスト層形成技術

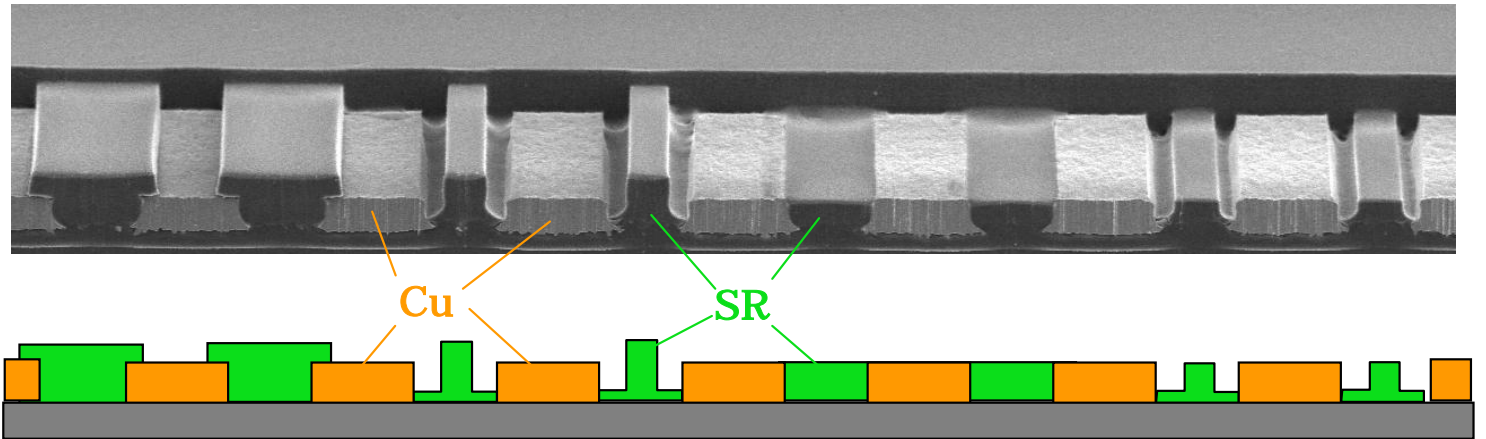
New Solder Resist Formation System

所望の段差形状のソルダーレジスト層形成ができます

Multi-stepped structure of Solder Resist easily achieved



多段ソルダーレジスト構造形成例 Example of Multi-Stepped Structure of Solder Resist



用途例

- ・ソルダーレジストの平坦化 / 薄層化
- ・アンダーフィルのダム加工
- ・セルフアライメントによるパッド露出 (フリップチップ実装の電極面露出)
- ・その他3次元構造体の形成

Flattened Solder Resist
Dam Formation for Underfill resin
Self-Aligned Electrode Pad
Any other Multi-Stepped Structure